

# 1

## 關於優群

1-1 公司簡介

1-2 公司產品

1-3 優群價值鏈

1-4 參與外部協會

## 1-1 公司簡介

### 1-1-1 基本資訊 (GRI 2-1、2-7)

優群科技成立於 1987 年，總部位於新竹市，主要經營筆記型電腦及電腦周邊、行動裝置產品、車用設備及網路通訊等相關連接器的設計、製造及銷售。本公司以高度自動化與垂直整合能力見長，藉由多年來所累積的產品設計、研發經驗及全球物流網絡的運籌帷幄，使優群不僅在連接器產業界佔有一席之地，更讓我們成為許多世界一級大廠所信任的合作夥伴。並致力於提供高品質、高效率的連接器產品，尤其在 DDR5、LPDDR5 CAMM2 等新世代連接技術領域中表現卓越。

|                                                                       |                                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>公司名稱 (2-1)</b><br>優群科技股份有限公司                                       | <b>成立時間</b><br>1987 年                      | <b>上櫃時間</b><br>2004 年 |
| <b>資本額 (2-6)</b><br>新台幣 901,042 仟元                                    | <b>2024 年營業額 (母公司)</b><br>新台幣 3,106,362 仟元 |                       |
| <b>公司所有權與法律形式 (2-1)</b><br>於 2004 年核准上櫃掛牌，組織型態屬於「股份有限公司」，公司所有權屬於全體股東。 |                                            |                       |
| <b>營運總部 (2-1)</b><br>300 台灣新竹市牛埔南路 15-3 號                             |                                            | <b>員工人數</b><br>119 人  |

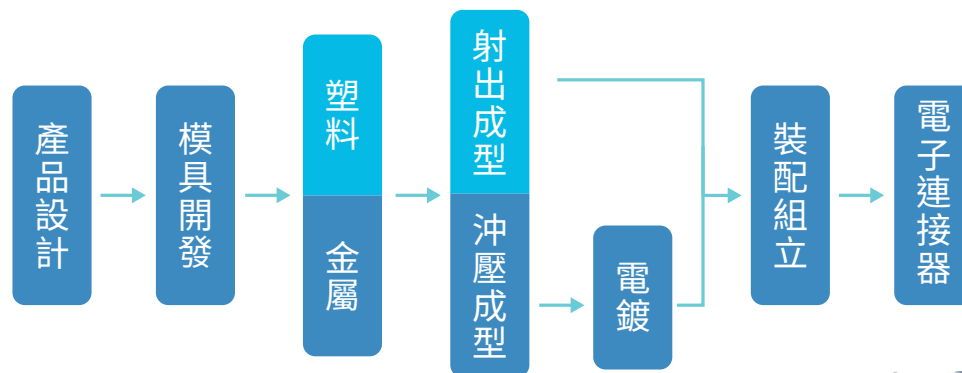
### 1-1-2 營運據點 (GRI 2-1)

本公司在台灣新竹、大陸江蘇、四川設有工廠，在大陸深圳、重慶、合肥、上海設有代表處。( 詳細資料，請見官網 )

## 1-2 公司產品 (GRI 2-6)

本公司多年來致力於生產製程的優化，並在高精密自動化生產設備的優化及產品高頻訊號傳輸設計上累積了相當豐富的經驗。產品開發除 DDR SO-DIMM、Long DIMM、M.2、Type-C 標準連接器及客製應用於行動裝置的 Metal Bar 五大系列外，2024 年我們成功推出 LPDDR5 CAMM2 (Compression Attached Memory Module II) 連接器，積極對產品規格的世代轉換提前佈局，並能成功應對產品規格升級所帶來的挑戰。

### 連接器之產製過程



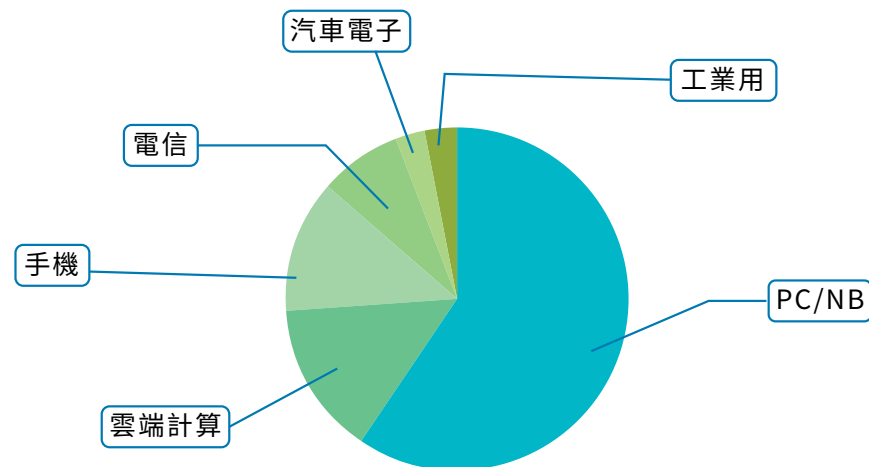


|        |                     |                                   |                     |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 主要產品   | DDR SO-DIMM Series  | M.2 Series                        | USB Type-C Series   |
| 應用     | DRAM SO-DIMM 記憶體卡插槽 | M.2 模組卡插槽                         | USB Type-C 插孔       |
| 客戶類型   | 新世代筆記型電腦用記憶體插槽      | 用於 AI PC、工作站、伺服器、路由器、網通設備等聯網及運算裝置 | USB 插口介面規格之 I/O 連接器 |
| 主要銷售地區 | 亞洲、美洲               | 亞洲、美洲                             | 亞洲、美洲               |



|        |                       |                         |
|--------|-----------------------|-------------------------|
| 主要產品   | DDR Long DIMM Series  | Micro Stamping Series   |
| 應用     | DDR DIMM 記憶體卡插槽       | 用於 SiP 模組上的 EMI 過濾或屏蔽零件 |
| 客戶類型   | 用於伺服器、桌上型電腦等之記憶體插槽連接器 | 用於新世代手持式行動裝置之特殊微型沖壓件    |
| 主要銷售地區 | 亞洲、美洲                 | 亞洲、美洲                   |

## ■ 終端客戶產業類型

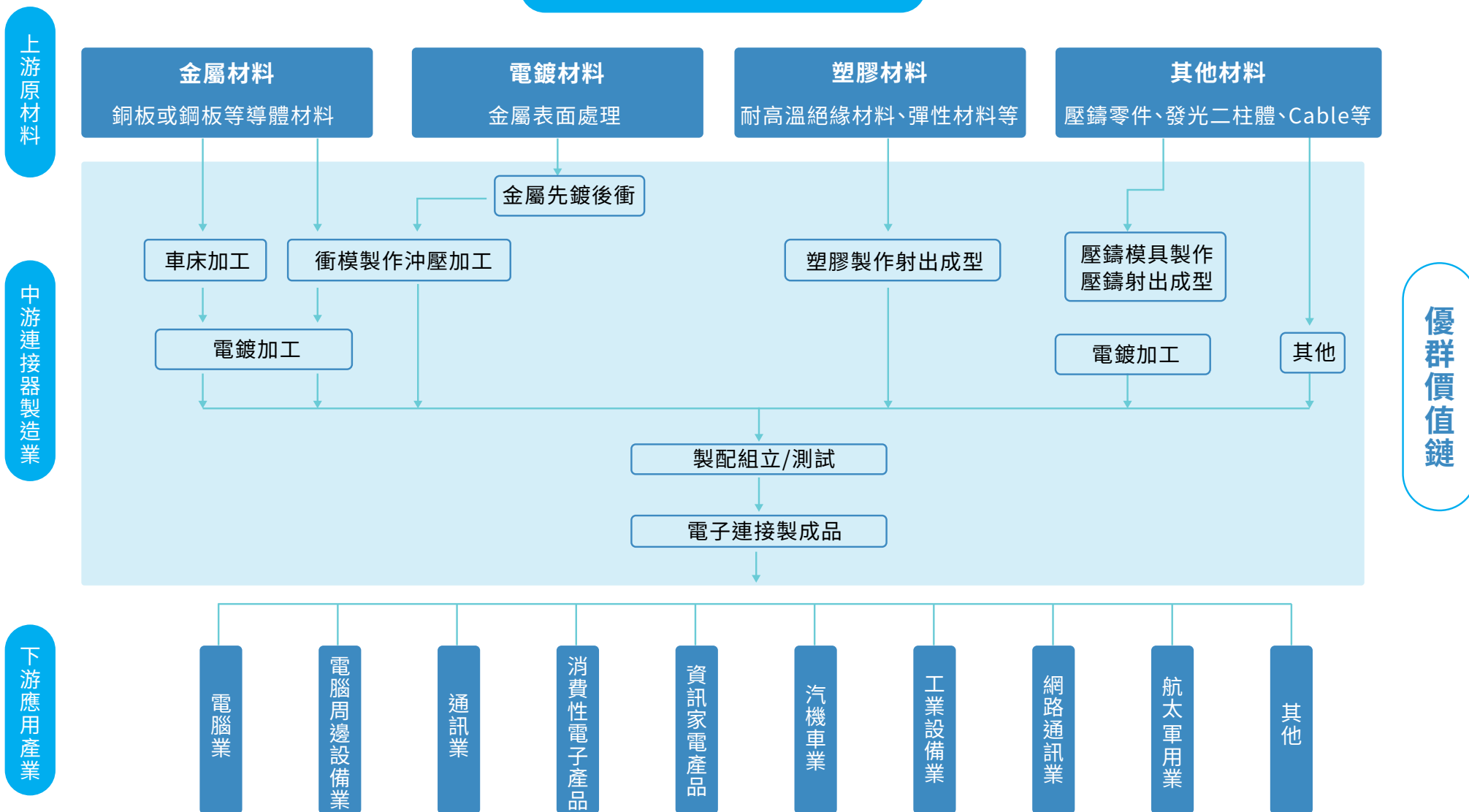


## 1-3 優群價值鏈 (GRI 2-6)

連接器的基本結構，分為接觸件、絕緣體、外殼、附件等。而連結器的主要原料包含金屬材料、塑膠、電鍍材料等。金屬材料主要屬於接觸件，為避免信號在傳輸過程中受到過多阻礙或衰退，多採用磷銅、黃銅、紫銅等銅材作為原材料；塑膠材料則用於外殼，以 PA、LCP 等為主；電鍍材料則以鍍金、鍍錫、鍍鎳和鍍銀等為主。依產品需求仍會加上部份組件。

上游主要原料共分為四大部份，中游為連接器產業所製造生產 (優群科技乃屬價值鏈的中游)，下游為各產業的應用，其圖示如下：

## 電子連接器之產業結構圖



## 1-4 參與外部協會 (GRI 2-28)

優群科技除了精進自身產品競爭力之外，亦積極參加外部協會與各界利害關係人溝通，藉由參與產業相關協會的交流活動，了解產業最新發展趨勢與各國相關規範。本公司參與之組織如下表：

| 組織                                                                 | 擔任職務     | 說明                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台灣電子連接產業協會 (TECA)                                                  | 理事長 / 會員 | 結合產、官、學、研共同促進電子連接器產業升級，例行舉辦專業培訓課程、國際商展及拓銷活動、提供產業市場資訊等服務，協調連接產業垂直整合，發揮產業力量推動產業升級。                          |
| 台灣以色列商業文化促進會 (TICC)                                                | 會員       | 為一非營利組織，其宗旨在促進台以雙邊經貿、科技、文化、教育及觀光交流合作。                                                                     |
| 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)                                        | 會員       | 取得即時資訊安全威脅情報，以提升組織資訊安全能量及符合資訊安全相關法規與標準要求。                                                                 |
| 公眾與環境研究中心 (IPE)                                                    | 會員 / 揭露方 | 致力於收集、整理和分析政府和企業公開的環境資訊，整合環境資料服務於綠色採購、綠色金融和政府環境決策，通過企業、政府、公益組織、研究機構等多方合力，撬動大批企業實現環保轉型，促進環境資訊公開和環境治理機制的完善。 |
| Carbon Disclosure Project (CDP)                                    | 會員 / 揭露方 | 全球非營利組織，經營著世界上唯一的獨立環境揭露系統。                                                                                |
| JEDEC Solid State Technology Association (JEDEC)                   | 會員 / 委員  | 微電子產業開放標準和出版物開發的全球領導者，委員會在製定廣泛技術標準方面發揮行業領導作用。                                                             |
| Open Compute Project (OCP)                                         | 會員       | 一個協作社區，致力於重新設計硬體技術，以有效支援對運算基礎設施日益增長的需求。制定了新的技術規範，培育了一個產業參與者在安全框架內協作的生態系統，塑造了多功能和多樣化的供應鏈。                  |
| Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) | 會員       | 致力於 PCI 標準的開發與增強，負責開發和維護外圍組件 I/O 資料傳輸的標準化方法。                                                              |
| Responsible Business Alliance (RBA)                                | 會員 / 揭露方 | 世界上最大的致力於全球供應鏈中負責任的商業行為的產業聯盟。                                                                             |
| Thunderbolt Community                                              | 會員       | 由開發業界領先的 Thunderbolt 設備的公司組成的全球生態系統。                                                                      |
| USB Implementers Forum (USB-IF)                                    | 會員       | 推廣與支援通用序列匯流排的非營利組織。主要的業務即是推廣與行銷 USB、無線 USB、USB OTG 與其相關規格標準的維護，同時也制訂施行相容性計劃。                              |